



2019年7月12日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表取締役社長 月 崎 義 幸
(コード番号：6740 東証一部)
問 合 せ 先 常務執行役員 菊 岡 稔
チーフフィナンシャルオフィサー
(TEL. 03-6732-8100)

**(開示事項の変更・経過) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、
第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ**

当社は、2019年6月28日付で開示した「(開示事項の変更・経過) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ(2019年6月28日付開示第2報)」(以下「2019年6月28日付開示第2報」といいます。)において、Suwa Investment Holdings, LLC(以下「割当予定先」といいます。)による当社が発行する普通株式(以下「本新株式」といいます。)及び株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本第2回新株予約権付社債」といいます。)に係る出資予定額として2019年4月12日時点において予定した額(払込金額の総額の合計：600億円)に対して、割当予定先が確保している資金が約117億円不足している旨をお知らせしておりましたが、昨日、割当予定先の出資予定者であるHarvest Tech Investment Management Co., Ltd.(以下「Harvest Tech」といいます。)のGeneral ManagerであるWinston Henry Lee氏(以下「Lee氏」といいます。)より、出資予定者の状況について報告を受けましたので、お知らせいたします。かかる状況を受け、当社は、本新株式、本第2回新株予約権付社債及び株式会社ジャパンディスプレイ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本第3回新株予約権付社債」といいます。)の発行に関する臨時株主総会を8月29日を目処に開催することを予定しております。加えて、当社は、当社の社内カンパニーであるモバイルカンパニーの子会社化について、子会社化の完了目途を変更するとともに、当該子会社における事業投資家からの資本参加の受入れを検討することといたしました。

具体的には、2019年6月28日付で開示した「(開示事項の変更・経過) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」(以下「2019年6月28日付開示」といいます。)でお知らせしたとおり、当社は、割当予定先の出資予定者であるHarvest Techから、当社が組成するファンド(以下「Harvest Tech Overseas Fund」といいます。)による、本新株式及び本第2回新株予約権付社債に係る出資(300百万米ドル(約325億円))の実行に必要なとされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター(300百万米ドル(約325億円))を受領するとともに、Harvest Tech Overseas Fundによる出資予定額300百万米ドル(約325億円)のうち100百万米ドル(約108億円)については、当社顧客から支援を受けることにより払込みに要する資金を確保する予定である旨の報告を受けておりましたが、昨日、Lee氏より、Harvest Tech Overseas

Fundによる出資予定額を300百万米ドル(約325億円)から400百万米ドル(約433億円)に変更し、上記当社顧客から支援を受ける100百万米ドル(約108億円)は、当該コミットメントレターにかかる300百万米ドルの内数ではなく、300百万米ドルに追加するものとして当社顧客から支援を受けることにより資金を確保する旨をHarvest Techと当社顧客との間で合意した旨の報告を受けました。

上記を踏まえると、当社が発行する本新株式及び本第2回新株予約権付社債に係る出資に関して割当予定先が確保している資金は、2019年6月28日付開示第2報でお知らせしたOasis Management Company Ltd. (以下「Oasis」といいます。)が運用又は助言するファンドからの最低コミット額である150百万米ドルの出資を含め、合計で550百万米ドルとなります。そして、2019年4月12日時点において当社が予定した払込金額の総額の合計(600億円)と比べると、為替等の影響により若干の不足が生じる可能性があります。Lee氏からは、Oasisより、割当予定先の出資予定者からの出資予定額の合計が当社に対する払込みの時点において為替等の影響により600億円を下回る場合には、当該不足分についてはOasisが出資を行う旨の連絡を受けている旨の報告を受けております。

以上のとおり、Lee氏からの報告は、2019年6月28日時点において割当予定先が確保している資金として不足していた約117億円について、割当予定先において調達の目処を立てたことを内容とするものとなります。

なお、本第3回新株予約権付社債に係る出資予定額(同:200億円)についても、2019年6月28日付開示でお知らせしたとおり、既にHarvest Techから、Harvest Tech Overseas Fundを通じての出資(出資予定額:200億円)に関して、出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受けており、また、当該出資を確約するコミットメントレターを受領しております。

かかる状況を踏まえ、当社は、2019年4月12日付で割当予定先との間で締結していたCAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT(以下「本資本業務提携契約」といいます。)について、一部内容を変更した上で割当予定先と再締結すること、及び、株式会社INCJが行う新規貸付及び優先株式の引受けによるリファイナンスについて最終合意することを前提に、本新株式、本第2回新株予約権付社債及び本第3回新株予約権付社債の発行に関する臨時株主総会を8月29日を目処に開催することを予定しております。当該臨時株主総会の開催については、決定次第速やかに開示いたします。

加えて、当社は、当社が2019年5月30日付で開示した「(開示事項の変更・経過)資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、定款の変更並びに資金の借入に関するお知らせ」において、当社の社内カンパニーであるモバイルカンパニーを新設分割その他の方法により、2019年9月末までに子会社化することについて検討を行うこととしておりましたが、子会社化の完了目途を2019年12月末までに変更するとともに、子会社における将来の有機EL(OLED)の更なる展開を視野に当社の顧客基盤と技術に関心を持つ事業投資家との資本業務提携を目指すため、当該子会社における事業投資家からの資本参加の受入れを検討することといたしました。当該分社化の実施に際しては当社の株主総会における特別決議が必要となることが想定されますが、詳細が決まり次第速やかに開示いたします。

(注)米ドルから日本円への換算は、為替相場(2019年7月11日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値の単純平均値)1米ドル=108.20円に基づいて算定したものです。

以上